

Программа семинара
Томск, пр. Ленина, 40, 15 сентября 2016 г. (вторник)

Время		Часов	Событие	Докладчик
9:00	10:00	1:00	Регистрация участников, утренний кофе	
10:00	10:15	0:15	Вступительное слово	Александр Васильев, ген. директор ООО «Остек-ЭК»
10:15	10:30	0:15	Приветствие участников, презентация компании EVG	Геральд Силберер, руководитель регионального направления компания EVG, Австрия
10:30	11:20	0:50	Передовые технологий производства 2,5D и 3D интегрированных модулей	Томас Урман, директор по развитию бизнеса, компания EVG, Австрия
11:20	12:10	0:50	Автоматизированная сборка ГИС модулей и систем в корпусе	Максим Фадеев, ведущий специалист, ООО «Остек-ЭК»
12:10	12:30	0:20	Кофе-брейк	
12:30	13:20	0:50	Сварка и временный монтаж пластин - обзор рынка и технологические новинки	Томас Урман, директор по развитию бизнеса, компания EVG, Австрия
13:20	14:10	0:50	Оборудование JEOL, NEOARK и NSC для полупроводниковой промышленности. Электронная микроскопия	Андрей Ляпин, главный специалист, ООО "Остек-АртТул"
14:10	15:00	0:50	Обед	
15:00	15:50	0:50	Технологии EVG в производстве составных полупроводниковых приборов (АШВУ, фотонные приборы)	Геральд Силберер, руководитель регионального направления компания EVG, Австрия
15:50	16:40	0:50	Технологические материалы для полупроводниковых и микроэлектронных производств	Алексей Галушко, начальник отдела, ООО «Остек-Интегра»
16:40	17:00	0:20	Кофе-брейк	
17:00	18:00	1:00	Технология LTCC	Сергей Чигиринский, начальник отдела, ООО «Остек-ЭК»
18:00	18:30	0:30	Заключительно слово. Вопросы.	Александр Васильев, ген. директор, ООО «Остек-ЭК»